



[kingston.com/emcp](http://kingston.com/emcp)

## eMCP

### La soluzione di storage integrata efficiente e potente per applicazioni mobili su dispositivi compatti, IoT e applicazioni integrate

Kingston offre un'ampia gamma di componenti eMCP conformi allo standard JEDEC. eMCP integra la tecnologia storage Embedded MultiMedia Card (eMMC) e LPDDR (Low-Power Double Data Rate) in un pacchetto multi-chip (Multi-Chip Package - MCP) caratterizzato da un formato particolarmente compatto. La soluzione offre un'elevato livello di integrazione a fronte di dimensioni compatte. eMCP è una soluzione ideale che integra componenti di storage e di memoria in un'unica soluzione progettata per l'impiego su dispositivi compatti e spazi limitati, come smartphone, tablet, dispositivi indossabili e vari dispositivi compatibili con le tecnologie dell'Internet delle cose (IoT).

## PRINCIPALI VANTAGGI

- Una soluzione NAND flash gestita che semplifica design e manutenzione dei prodotti con un'interfaccia standard di settore eMMC. Ciò riduce significativamente le complessità di progettazione e i cicli di qualificazione dei prodotti.
- La combinazione tra memorie e storage altamente integrati riduce lo spazio in termini di progettazione dei sistemi, rendendo i dispositivi eMCP una soluzione ideale per le applicazioni di formato compatto.
- L'uso di DRAM a basso consumo riduce i consumi energetici complessivi, facendo di eMCP la soluzione ideale per numerose applicazioni alimentate a batteria, come quelle tipicamente associate a dispositivi indossabili e prodotti IoT.
- Ridotta complessità delle liste BOM, in termini di riduzione dei componenti presenti.
- Sono disponibili molteplici configurazioni firmware, per adattarsi ai requisiti delle applicazioni in termini di prestazioni, potenza e durata del ciclo di vita.

## FASCE DI MERCATO



Smartphone e Tablet



Indossabili



Acceleratori IA



IoT

## NUMERI DI PARTE E SPECIFICHE eMCP

### eMCP basate su LPDDR3

Numero di parte	Capacità		Standard		Pacchetto	FBGA	Temperatura di funzionamento
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C ~ +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C ~ +85°C

### eMCP basate su LPDDR4x

Numero di parte	Capacità		Standard		Pacchetto	FBGA	Temperatura di funzionamento
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	149	-25°C ~ +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C ~ +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C ~ +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C ~ +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C ~ +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,1	254	-25°C ~ +85°C



IL PRESENTE DOCUMENTO È SOGGETTO A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

©2022 Kingston Technology Europe Co LLP e Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Regno Unito. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi e i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi titolari. MKF-961IT